|  |
| --- |
| 2025년 My Chip 경진대회 심사용 논문여기에 제목을 입력하세요(Put English Title Here)요 약이곳에 한글 요약문을 작성하여 주십시오. (스타일:요약본문) 이곳에 한글 요약문을 작성하여 주십시오. (스타일:요약본문) 이곳에 한글 요약문을 작성하여 주십시오. (스타일:요약본문) 이곳에 한글 요약문을 작성하여 주십시오. (스타일:요약본문) 이곳에 한글 요약문을 작성하여 주십시오. (스타일:요약본문) 이곳에 한글 요약문을 작성하여 주십시오. (스타일:요약본문) 이곳에 한글 요약문을 작성하여 주십시오. (스타일:요약본문) 이곳에 한글 요약문을 작성하여 주십시오. (스타일:요약본문) AbstractPlease put the abstract of paper here.(스타일:요약본문) Please put the abstract of paper here.(스타일:요약본문) Please put the abstract of paper here.(스타일:요약본문) Please put the abstract of paper here.(스타일:요약본문) Please put the abstract of paper here.(스타일:요약본문) Please put the abstract of paper here.(스타일:요약본문) Please put the abstract of paper here.(스타일:요약본문) Please put the abstract of paper here.(스타일:요약본문) Keywords : 5개이하의 키워드를 입력하시오. (스타일:Keywords내용)  |
|  |

Ⅰ. 서 론

여기에 서론을 입력하세요. (스타일:본문)

Ⅱ. 본 론 (스타일:각 장 제목)

1. 각 절 제목 (스타일:각 절 제목)

여기에 내용을 입력하세요. (스타일:본문)

가. 각 항 제목 (스타일:각 항 제목)

여기에 내용을 입력하세요. (스타일:본문)

(1) 각 항 제목 (스타일:각 항 제목)

여기에 내용을 입력하세요. (스타일:본문)

여기에 내용을 입력하세요. (스타일:본문)

여기에 내용을 입력하세요. (스타일:본문)

**표와 그림 : 영문 (tables and figures in English)**

그림 1. 여기에 그림 제목을 입력하세요 (마침표삭제)여기에 그림 제목을 입력하세요 (마침표삭제)

Fig. 11. Please put the title of figure here. Please put the title of figure here.

수식 맨 끝에 번호를 기입하세요.

 (1)

표 1. 여기에 그림 제목을 입력하세요(마침표삭제) 여기에 그림 제목을 입력하세요(마침표삭제)

Table 1. Please put the title of table here. Please put the title of table here.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Ⅲ. 실 험

여기에 내용을 입력하세요.

Ⅳ. 결 론

여기에 내용을 입력하세요.

REFERENCES

[1] S. X. Wang and A. M. Taratorin, Magnetic Information Storage Technology, Academic Press, 1999, ch. 12.

[2] B. Jeon and J. Jeong, "Blocking artifacts reduction in image compression with block boundary discontinuity criterion," IEEE Trans. Circuits and Systems for Video Tech., Vol. 8, no. 3, pp. 345-357, June 1998.

[3] W. G. Jeon and Y. S. Cho, "An equalization technique for OFDM and MC-CDMA in a multipath fading channels, " in Proc. of IEEE Conf. on Acoustics, Speech and Signal Processing, pp. 2529-2532, Munich, Germany, May 1997.

<<References 작성요령>>

**영문으로 작성요망**

**논문지** : 저자명, 제목, 논문지명, 권, 호, 쪽, 년월

**단행본** : 저자명, 도서명, 출판사명, 쪽, 년도.

**학술회의 논문지** : 저자명, 제목, 논문지명, 쪽, 개최장소, 국가, 년월.

※ 논문지명(잡지포함) 또는 도서명은 이탤릭체로 표기한다.

※ 본문에서 인용한 참고문헌 번호는 인용문 우측 상단의 []안에 기입한다.

예) [1]. 윗첨자

<<폰트문제>>

본 한글스타일 파일에서는 기본폰트를 사용하므로 논문지에 실리는 게재논문의 폰트와는 다를 수 있다.

**보충자료 (Supplement)**

**■ 『내 칩 제작 서비스』 참여자 정보**

1. 『내 칩 제작 서비스』 참여 차수 및 신청 번호: (예) 2024년 2차, MPW250605002

2. 『내 칩 제작 서비스』 참여 당시 팀 구성원의 학년 (참여자 성명은 기재하지 않음)

- 참여자1: 학부과정/석사과정/박사과정, O학년

- 참여자2: 학부과정/석사과정/박사과정, O학년

- 참여자3: 학부과정/석사과정/박사과정, O학년

- 참여자4: 학부과정/석사과정/박사과정, O학년

3. 『My Chip 경진대회』 이전 동일 내용으로 논문 제출 여부 : (O, X)

*\* 대한전자공학회 추계학술대회 논문집 게재 여부를 판단하기 위한 것이며, 경진대회 심사와는 무관함*

**■ 회로 설계 및 칩 평가의 과정, 결과 등 경진대회 심사를 위한 보충자료**

*\*『내 칩 제작 서비스』신청서, 결과보고서 등의 내용을 토대로 5페이지 내외 작성 (아래 예시)*

**1. 회로 설계 내용**

*\* 회로명, 회로도 및 Block Diagram, 레이아웃, 예상 성능, DRC/LVS/PEX 검증 등의 내용을 작성*

**2. 칩 평가 방법**

*\* 패키지 칩 또는 bare die 평가를 위한 측정환경, 평가 항목 및 측정 방법 (또는 계획) 작성*

**3. 칩 평가 결과 및 고찰**

*\* 칩 평가 결과와 설계값과 측정값을 비교하여 분석한 내용, 결론 및 소감 등을 작성*